

-----<第 88 回 イノベーション交流分科会 議事録>-----

1. タイトル:「半導体産業の未来」

2. 講師:テカナリエ社 代表 清水洋治氏

3. 日時:2024 年 5 月 10 日(金)PM6 時—8 時、 オンライン形式

4. 内容:

① プロローグ

- ・半導体狭義の市場よりも、エレクトロニクス、さらにはサービスへの広がりとして捉えるべき
- ・プロセッサ→システム→サービスの垂直化(自分で作って自分で使う)の動きあり。
- ・日本人の慎ましさは通用しない。

② The Lost Days

- ・日本は「一品ものでバラバラ、職人的」、海外は「セット重視で統合的」
- ・日本は長期的視野を持っていなかったなので、重要な萌芽を潰してしまった

③ 2023-2024 Apple

- ・Silicon in Package, Scalable Processor 化が進んでいる

④ 2023-2024 Mobile Processor

- ・Qualcomm, Huawei が自社製化率が高く、OS まで含めると Huawei が自社製化 No.1

⑤ 増殖 NVIDIA

- ・演算性能で優れるが、省電力性では未だ不十分
- ・ChatGPT, LLM-AI 時代では、より微細化が必要
- ・ソフトウェア(CUDA)によるユーザー支持も重要

⑥ Chiplet の真の狙い

・必要機能を統合した Chiplet Silicon Base on Package により、提供サイドのパワー強化とブラックボックス化が進む

- ・Apple VisionPRO は未だ高価だが相当進歩性がある

⑦ブランドとキット化

- ・日本企業のブランド力はシニア層にのみ通用する
- ・ブランド化・コアコンピタンス強化には、情報集結の場づくりが重要
- ・一回性から多回性へ、専門知から集合知への転換が必須
- ・「サービス事業」から商品・半導体の要求仕様を求める逆発想、一筆書きができる人材が必要
(要求仕様・システム設計、構想の視線の広さ・グローバルかつ長期的な視座など)

5. Q&A

- ・ラピダス社の今後について
- ・水平垂直のあり方
- ・日本企業の課題について
- ・人材育成について